

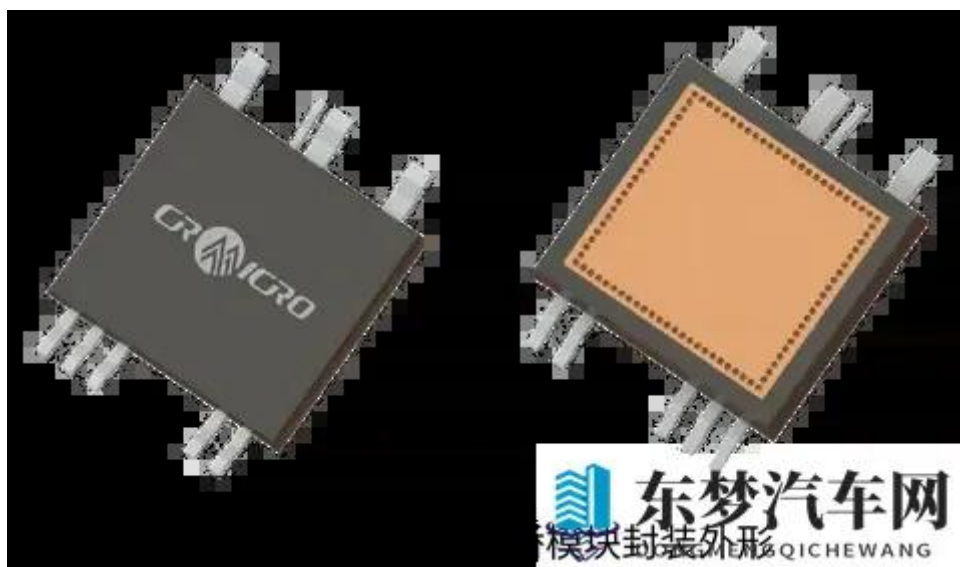
MSOP9系列车规半桥模块，华润微电子上新！

来源：许庆松 发布时间：2025-11-11 23:10:55

华润微电子功率器件事业群宣布推出新一代MSOP9系列车规半桥模块，为新能源汽车行业带来突破性的技术升级和优质产品体验。

据介绍，MSOP9系列车规半桥模块，是基于MSOP8封装平台迭代升级的最新成果，其综合性能已达到国际先进水平。相较于上一代产品，该模块创新性地将NTC合封到模块内部，显著提升集成度，能够为客户提供更高效可靠的解决方案。

华润微电子功率器件事业群透露，该产品具备以下优点：



参数一致性好小尺寸、高功率密度低杂散电感(模块和系统)顶部散热能力大幅优于传统贴片产品可靠的隔离(爬电距离)满足AEC-Q101、AQG324汽车电子功率模块认证要求

MSOP9系列车规半桥模块提高了集成度，简化系统设计，内置（热敏电阻）保护功能。首先，能够直接利用功率半导体芯片内部集成的温度传感器进行监测，芯片内部集成温度传感器，直接读取核心温度，数据精准可靠；基于精准数据实现提前过温保护，大幅提升系统可靠性与寿命；为实现更精准的功率循环和最大化输出能力提供数据基石。其次，传感器引脚与同电位的功率/控制引脚相邻设置，实现更小引脚间距；紧凑的布局为其他关键引脚留出宝贵布线空间；轻松满足严格的爬电距离，简化布局设计，降低开发难度；同电位引脚间天然干扰小，保障了温度信号采集的纯净与稳定。



华润微电子功率器件事业群表示，该产品的应用优势还在于适用于OBC、DC-DC等桥式拓扑平台；贴片封装，装配灵活，系统杂感低；减小PCB尺寸和BOM复杂性；优异的热性能，优化冷却系统设计。

全新的MSOP9系列车规半桥模块产品列表如上图所示，该系列模块集高可靠性、强鲁棒性、高功率密度等优异特性于一身，目前已通过严格的车规级可靠性测试。

产品名	封装	Feature	BV _{DSS} (V)	I _D (A)
CRJMH75M65NMAQ	MSOP9	NTC	650	75
CRJMH74M65NMAQ	MSOP9	NTC	650	62
CRJMH43M65NMAQ	MSOP9	NTC	650	32
CRJMH36M65NMBQ	MSOP9	/	650	25
CRJMH60M65NMBQ	MSOP9	/	650	43
CRXMH40P120NMG2AQ	MSOP9	NTC	1200	40
CRXMH17P120NMG2AQ	MSOP9	NTC	1200	17
CRXMH32P120NMG2AQ	MSOP9	NTC	1200	32
CRXMH37P075NMG1AQ	MSOP9	NTC	750	37
CRXMH65P170NMG2AQ	MSOP9	NTC	1700	65
CRXMH97P065NMG2AQ	MSOP9	NTC	650	97
CRXMH97P065NMG2BQ	MSOP9	/	650	97
CRGMF40T120DNMC3Q	MSOP9	NTC	1200	40
CRGMF50T120DNMC3Q	MSOP9	NTC	1200	50

想要获取半导体产业的前沿洞见、技术速递、趋势解析，关注我们！

HTML版本： [MSOP9系列车规半桥模块，华润微电子上新！](#)